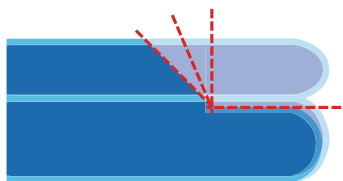
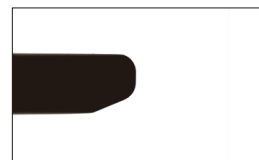
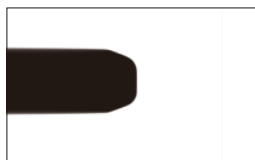


# あらゆるウェーハ素材に対応するEDGE Grinder

EDGE Grinder for Various Materials

## SiC, GaN, GaAs 等 様々な材料・形状加工を 提供いたします

Technology Solutions  
for Wide Range of Needs in  
EDGE Grinding Process



### 5 EDGE 面取りプロセス導入による 5つのメリット 5 ADVANTAGES

- 1** 搬送時のチッピングによるワレ・カケを低減  
Protects the wafer edge from chipping and breaking
- 2** 加工プロセスの短縮、ランニングコストの減少  
Shorten the process step and reduce running cost
- 3** コインマークレス、クラック減少、  
ウェーハエッジ上の膜等不要箇所の除去  
Improves quality, coin markless, crack reduction,  
removes defective area on wafer edge
- 4** ナイフエッジ防止  
Prevents sharp knife edge
- 5** 次の工程の為の様々なエッジ形状、  
高精度 Notch 形状、OF の成形  
Changes edge shape for the following process and accurate  
Notch / OF shape

